

PECVD - Oxford NGP80

E-mail	Telefone	Responsável
cioldin@unicamp.br	3521-7282	Frederico Cioldin

O descumprimento de qualquer uma das regras a seguir acarretará na suspensão temporária ou permanente do usuário.

Segurança

- O PECVD é utilizado a temperaturas de até 400 °C. **CUIDADO AO CARREGAR E DESCARREGAR A CÂMARA.**
- Os gases utilizados são pirofóricos, tóxicos e oxidantes. Em caso de emergência contatar o responsável.
- O usuário deve estar sempre presente na sala durante a operação.

Exigências (Mandatário!)

- Preencha o *logbook* com a receita utilizada e tempo de deposição. Adicione qualquer informação relevante ou peculiaridades ocorridas ao longo do processo.
- O ciclo de limpeza deve ser realizado após cada deposição.
 - É responsabilidade do usuário incluir o tempo de limpeza em seu período de agendamento;
- Após finalizar o uso do equipamento:
 - Faça LOG OUT.
 - Informe ao técnico responsável do término do processo para que ele possa esvaziar a linha de gases tóxicos.

Restrições de materiais

- Apenas WAFERS DE SILÍCIO são permitidos na câmara. A utilização de amostras contendo qualquer outro tipo de material (RESISTES, METAIS, FILMES DEPOSITADOS, etc) deve passar pela aprovação do técnico responsável.

Restrições de parâmetros

- Apenas executar receitas padrão.
- Não alterar qualquer uma das receitas sem aprovação prévia do técnico responsável.